



80th Anniversary

Okamoto

SEMICON[®] Japan2015 セミコンジャパン2015出展のご案内
12/16^水~18^金 東京ビッグサイト

Booth No. **2528 (HALL2)**

後工程・総合・材料ゾーン

ハイブリッドマテリアルの総合砥粒加工提案

難削材に対して

SiC, GaN等への低ダメージ、高速加工技術と装置の提案

パッケージに対して

樹脂及び金属の複合体同時研削加工技術の提案

- その他、岡本工作機械製作所はお客様に豊富なご提案をご用意いたしております。

TSV

Cuコンタミネーション対策新プロセスと最新装置の提案

MEMS

高精度、チップングレス加工技術の提案

450mmウェーハ加工

450mm対応装置の提案

大型材料

ガラス、セラミック等の大型材料加工装置の提案

岡本工作機械

<http://www.okamoto.co.jp>

半導体営業課 〒379-0135 群馬県安中市郷原2993 TEL: 027-385-6211 FAX: 027-385-1144